

## Система контроля механических напряжений DP-FS8R



### Характеристики

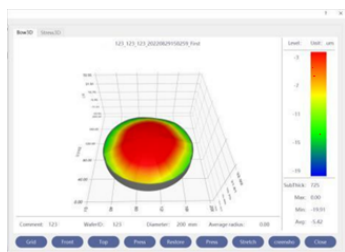
#### Описание

Установка DP-FS8R представляет собой удобное и компактное решение для контроля и измерения механических напряжений полупроводниковых пластин бесконтактным методом (лазерное сканирование как у FLX-2320 (Toho Technology Inc.)). Обеспечивает высокую точность, стабильность и повторяемость результатов в широком диапазоне измерений. Интуитивно понятный интерфейс и небольшие размеры установки - идеальное решение для ежедневного рутинного исследования большого количества образцов. Позволяет проводить измерения пластин диаметром 100 - 200 мм (опционально до 300 мм).

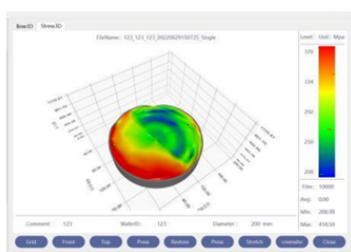


## Область применения

- Измерение механических напряжений тонких пленок на поверхности полупроводниковых пластин бесконтактным методом.
- Контроль поверхности пластин после технологических операций проволочной резки слитков, шлифовки, полировки, утонения, травления и нанесения тонких пленок.



Bow 3D image



Stress 3D image

## Особенности

- Наличие двухволнового лазера позволяет в автоматическом режиме переключаться в зависимости от отражающей поверхности образца, что позволяет проводить измерения широкого спектра различных материалов тонких пленок на подложках из Si, poly-Si, SiC, GaAs, GaN, Ge, InP и др.
- Встроенное программное обеспечение позволяет вращать объект измерения, имеет удобный интерфейс для управления и представления результатов измерений, в том числе высоту прогиба и диаграмму напряжений.
- Экспорт данных 3D моделей напряжений.
- Наличие журнала записи с возможностью просмотра результатов измерений.

## Параметры измерения

Parameter Settings ? X

Substrate Material: 1.805 Si 100 100GPa

Substrate Thickness: 525  $\mu$ m

Wafer Type: 4 inch

Measurement Laser: 670nm

Repeated Measure: 1 Second

Edge removal

Left: 10 mm Right: 10 mm

unit:  MPa  Dyne/cm<sup>2</sup>

wafer :  Flat  Gap

Save Result data  Auto Stress Calculation

Auto Change Laser Min Voltage: 0

Load Save Temporarily